

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京燕东微电子股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-56051430 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：田东阁	联系方式：010-86451640 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2575 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）179,865,617 股，每股面值 1 元。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕1304 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）225,083,986 股，每股面值 1 元。本次公司发行股票的发行价格为 17.86 元/股，募集资金总额为 402,000.00 万元，扣除发行费用 1,492.26 万元，实际募集资金净额为 400,507.73 万元。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任公司首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐人、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，	保荐人、保荐代表人已协助、督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和《上海证

序号	工作内容	持续督导情况
	并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	券交易所科创板股票上市规则》的要求,并确保公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均已明确知晓其在相关规则下的各项义务。
2	<p>保荐人、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐人、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助,确保其信息披露内容简明易懂,语言浅白平实,具有可理解性。</p> <p>保荐人、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务,告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p>	<p>保荐人、保荐代表人已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平;已对上市公司信息披露公告文件的制作提供必要指导和协助,并确保内容简明易懂、语言浅白平实、具有可理解性;已督促公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务,告知并督促其不得要求或协助公司隐瞒重要信息。</p>
3	<p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的,保荐人、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐人、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项,持续跟进相关主体履行承诺的进展情况,督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项,不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的,保荐人和保荐代表人应当及时提出督导意见,并督促相关主体进行补正。</p>	<p>保荐人、保荐代表人已督促相关主体对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等进行充分信息披露;已持续跟进相关主体履行承诺的进展情况,督促其及时、充分履行承诺;未发现上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项存在不符合法律法规及其他相关规定的情形。</p>
4	保荐人、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者,建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人、保荐代表人已督促上市公司建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度,积极回报投资者。
5	<p>保荐人、保荐代表人应当持续关注上市公司运作,对上市公司及其业务有充分了解;通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式,关注上市公司日常经营和股票交易情况,有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。</p> <p>保荐人、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,保荐人、保荐代表人应当发表意见予以说明。</p>	<p>保荐人、保荐代表人已持续关注上市公司运作,对上市公司及其业务有充分了解;已通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式,关注上市公司日常经营和股票交易情况;本持续督导期间,上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。</p>
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的,保荐人、保荐代表人应当督促上市公司及	在本持续督导期间,上市公司股票未出现严重异常波动。

序号	工作内容	持续督导情况
	时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	
7	保荐人、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐人、保荐代表人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，前述主体在本持续督导年度内未减持公司股份。
8	保荐人、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人、保荐代表人已持续关注上市公司募集资金使用情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

## 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### （一）业绩亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入 183,326.35 万元，同比增长 7.56%，归属于上市公司股东的净利润-40,780.75 万元，持续亏损。产品解决方案板块积极开拓增量业务，持续提升产品竞争力，推动产品解决方案业务板块持续发展，收入金额同比增长 4.74%；制造服务板块，面对外部激烈的市场竞争，公司坚持技术与产品创新，持续强化战略客户拓展，推动产品交付能力提升，收入金额同比增长 8.54%；另一方面，12 英寸生产线目前尚处于产能爬坡阶段，生产规模有限，单位产品分摊的成本金额较高，导致单位成本较大。因此导致制造服务毛利率为负值。公司已经采取积极措施，加大研发投入，募投项目建设稳步推进，未来随着市场好转，12 英寸生产线逐渐达到设计产能，公司 12 英寸产线的产能利用率将持续提高，产品成本有待进一步降低，持续经营能力不存在重大风险。

### （二）核心竞争力风险

考虑到半导体产业周期性以及产品快速迭代等因素公司面临核心竞争力风险主要包括以下方面：首先，新产线建设周期较长、资本投入较大，若建设进度、产能释放或工艺水平不及预期，将直接影响公司交付能力与市场竞争力，进而对经营业绩产生不利影响；其次，精益管理不足可能导致成本偏高、效率偏低，削

弱盈利优势；此外，若客户需求变化或服务响应不及时，存在客户流失风险，进而影响市场份额与经营业绩。

### **（三）经营风险**

#### **1、行业周期性及公司经营业绩波动风险**

半导体行业具有较强的周期性特征。如果消费电子等下游行业整体出现较大周期性波动，公司未能及时判断下游需求变化，或者受市场竞争格局变化、公司产能利用率走低、研发不及预期等因素影响，导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司收入持续增长存在不确定性风险。

#### **2、客户集中度较高的风险**

公司客户相对集中，如果未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，可能导致公司订单下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险**

公司生产依赖于多种原材料，原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。如果未来公司主要供应商因产能紧张而大幅提升售价、推迟供货，或者由于国际政治及其他不可抗力等因素，停止向公司供货，将导致公司短期内材料供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

#### **4、核心技术泄密风险**

新产品、新工艺持续开发能力是集成电路企业的核心竞争力，经过近 40 年的发展与积累，公司形成了一定数量的发明专利和非专利技术，这些技术成为公司在市场竞争中取得成功的重要依托。如果公司核心技术被竞争对手窃取或抄袭，则可能产生核心技术泄密风险，导致公司产品与方案业务及制造与服务业务的市场竞争力下降。

### **（四）财务风险**

#### **1、信用风险**

公司主要客户均为长期合作、信用水平较高、应收账款回款良好的企业，且公司对应收账款余额进行持续监控，但如果市场环境发生不利变化、部分客户出现经营风险而不能按时回款，公司可能存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

## **2、存货风险**

随着公司经营规模和经营业绩的不断扩大，期末存货余额可能会随之提高，如果公司存货管理不够科学，占用公司的营运资金，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## **3、利率风险**

公司负债率较低，由于市场利率变动的风险与公司借款相关，所以利率风险对公司影响较小。

## **4、流动性风险**

为了满足公司日常经营需要，公司现金及现金等价物充足，并对其进行实时监控，因此公司所承担的流动风险较低，对公司的经营和财务报表不构成重大影响。

# **（五）行业风险**

## **1、行业竞争风险**

在市场需求不断扩大、中国大陆产业影响力不断提升的大背景下，半导体产业整体面临着良好的行业发展机遇。但是，现有市场参与者持续扩大产能，以及新进入者的不断涌现，将进一步加剧市场竞争。如果公司不能把握市场行业发展规律、持续研发创新并提升生产管理效率，不断优化产品设计，升级产品制造工艺，可能导致公司跟不上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，产品失去竞争力，对公司业绩产生影响。

## **2、产业政策变化风险**

半导体产业是我国的战略性产业，近年来获得了国家一系列政策的大力支持。在产业政策支持和国民经济发展的共同推动下，我国半导体行业设计能力、生产

工艺、创新水平均取得了较大的提升。如果，未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下降、产业发展速度变缓等情形，影响到公司经营。

#### （六）宏观环境风险

半导体产业宏观环境风险主要来自需求传导、贸易限制与投资波动。全球经济增速预计放缓，贸易限制措施增加，影响半导体产业链进出口与供应链稳定。中美关系趋紧，技术出口管制升级，限制先进制程设备采购与技术迭代，或将制约企业发展策略实施与竞争力提升。同时，高稳定行业客户采购受宏观政策与预算调整影响较大，导致核心业务订单稳定性不足，进一步放大宏观环境波动带来的经营风险。

#### 四、重大违规事项

在本持续督导期间，燕东微不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年1-12月	2024年1-12月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,833,263,543.04	1,704,338,864.85	7.56
归属于上市公司股东的净利润	-407,807,520.25	-178,115,909.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-896,601,055.49	-288,028,775.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	580,342,989.51	318,684,153.62	82.11
主要会计数据	2025年12月末	2025年12月末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,330,351,381.47	14,677,831,705.75	24.88
总资产	37,090,872,201.23	24,060,196,692.14	54.16

公司主要财务指标如下表所示：

单位：元

主要财务指标	2025年1-12月	2024年1-12月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	不适用

主要财务指标	2025年1-12月	2024年1-12月	本期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.69	-0.24	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.52	-1.21	-1.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.55	-1.95	-3.60
研发投入占营业收入的比例(%)	43.74	19.91	23.83

2025年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长82.11%，主要系公司政府补助增加所致；公司总资产同比增长54.16%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 硅光平台国内领先，商业化进程加速

硅光项目产业化进程加速。8英寸SiN平台自主研发工艺实现关键指标突破，传输损耗低于0.1dB/cm，达到行业量产先进水平；产品全年产出1.48万片；12英寸SOI平台加速起跑，重点攻关低损耗波导、高速调制器与探测器等核心工艺模块，如期发布PDK，启动战略客户导入。此外，引进行业领军技术团队，开展异质集成、光电集成等关键工艺研发，大幅提升硅光工艺平台竞争力，在硅光这一前沿技术领域，实现从“跟跑追赶”到“并跑领跑”进阶。

### (二) 研发投入加码，特色工艺实现持续突破

公司锚定研发强投入，持续攻坚特色工艺，创新动能稳步攀升。通过引进和自身培养，截至2025年底公司研发人员552人，占比14.26%。凭借精准引才、系统育才、科学用才、激励锁才，公司构建起多层次人才体系，为技术迭代提供核心支撑。2025年公司研发费用达8.02亿元，同比增长136.24%，研发投入占营收比例高达43.74%。多个工艺平台取得重大突破，其中，制造服务方面，12英寸SOI硅光工艺平台、0.18um CMOS工艺平台、功率器件平台均取得关键突破；8英寸BCD平台攻克了中压、高压和超高压器件等百余种器件的兼容和隔离、超高压器件结构和工艺设计等核心技术难题，发布PDK；6英寸650V/1200V SiC SBD工艺平台实现量产。产品解决方案方面，高稳定IC CMOS工艺平台持

续优化，完成 54ACS、模拟开关系列等核心器件国产化替代；此外，积极推进 IGBT、射频 LDMOS 等新产品研制，20 余款新品转量产。2025 年，公司新增专利申请 102 件，新增专利授权 53 件，技术护城河持续巩固。

### **（三）深化精益管理，运营效率显著提升**

公司强化深化精益管理，产出与良率实现持续突破，主要产线生产数据屡创历史新高：6 英寸产线全年累计产出超 69 万片，8 英寸产线全年累计产出超 63 万片，燕东科技 12 英寸产线单月最高产出超 2 万片，整体运营效能与产能规模同步迈上新台阶。此外，公司以生产运营提产能、数字化建设强协同、质量管控稳良率、供应链降本增效益为核心全方位优化流程，生产经营效率和综合竞争力持续增强。

### **（四）客户数质同步提升，提高发展韧性**

公司紧扣半导体国产替代机遇，依托特色工艺与产线优势精准匹配需求，聚焦新能源、汽车电子等高端赛道，加大战略客户开拓与深度绑定力度。燕东科技客户结构持续改善，持续导入战略客户；北电集成强化细分领域头部客户开拓，加快平台建设和新品验证；四川广义头部客户出货量创历史新高。此外，在硅光领域牵手头部企业，实现多领域客户规模与质量同比提升，显著提高产业链抗风险能力与发展韧性。

## **七、研发支出变化及研发进展**

### **（一）报告期内获得的研发成果**

1、基于北电集成 12 英寸集成电路生产线项目，加速产线建设，按规划节点推进重点技术研发与攻关，完成 3 个工艺平台搭建，为产品规模化量产奠定坚实基础。

2、基于成套国产装备的燕东科技 12 英寸生产线，依托核心技术突破与工艺平台搭建，推动产能加速释放，实现技术与产业协同发展。其中：

（1）SOI 硅光工艺平台：成功在 SOI 平台上实现低损耗 SiN 波导的异质集成，其传输损耗达业界先进水平，与业界头部企业开展深度项目合作，加速产品化落地；

(2) CMOS 工艺平台：实现 0.18um CMOS 平台工艺通线，各项电性参数均达标，性能匹配业界主流水平，首家客户产品已通过验证，多家客户产品导入中；

(3) 功率器件工艺平台：完成 Trench NMOS 工艺平台搭建，导入上百款芯片，90%产品进入量产阶段；完成中/低压 HDP SGT、TOX SGT、ESD Trench MOS、650V IGBT 多个工艺平台搭建，SGT 平台代表产品进入量产阶段。

3、基于成套国产装备的 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，加速产品结构调整，促进业务版图拓展，实现产能与效益提升，其中：

(1) SiN 硅光工艺平台：实现规模化量产，累计产出达 1.48 万片，产能达 3,000 片/月，平台稳定性和交付能力持续提升；

(2) BCD 工艺平台：0.35um 600V BCD 平台完成了中压、高压和超高压器件等百余种器件的兼容和隔离、超高压器件结构和工艺设计等核心技术难题，发布 PDK；

(3) IGBT 工艺平台：完成平面 1200V/1700V 和沟槽 650V 平台全流程开发和工艺固化，典型产品通过 1000h 可靠性评测；完成 4500V 高压 IGBT 平台工艺开发；

(4) RF-LDMOS 工艺平台：实现全流程贯通，2.45G 产品工程批产出，通过客户验证；

(5) TVS 工艺平台：完成 Trench TVS 工艺平台搭建，典型产品完成流片和用户验证；

4、基于 6 英寸 SiC 生产线，持续提升工艺能力，加速丰富器件类型，完成小 pitch MOSFET 技术验证版产品流片。

5、产品解决方案方面，基于自身设计工艺技术，年内实现以下系列产品开发与量产：

(1) 高压射频 VDMOS 芯片：完成 7 款高压射频 VDMOS 产品研制；

(2) IGBT 功率模块：完成代表产品开发，通过可靠性评测；

(3) 高密度保护器件：完成代表产品开发，通过客户试用。

## (二) 报告期内获得的知识产权列表

项目	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	41	18	216	111
实用新型专利	61	35	401	351
外观设计专利	0	0	0	5
软件著作权	0	0	19	18
其他	26	0	93	60
<b>合计</b>	<b>128</b>	<b>53</b>	<b>729</b>	<b>545</b>

## (三) 研发投入情况表

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	801,816,963.60	339,413,077.59	136.24
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	801,816,963.60	339,413,077.59	136.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	43.74	19.91	增加 23.83 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

报告期内，公司研发投入同比增长 136.24%，主要系公司高度重视产品研发及技术创新，通过扩充研发人员，并积极推动新工艺技术的开发平台所致。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### (一) 首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	余额 (元)
募集资金专项账户结余	375,651.34
截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	377,405.48

项目	余额（元）
(1) 募集资金投资项目投入	134,970.51
其中：本年度募集资金投资项目投入	-
(2) 募集资金投资项目先期投入及置换	165,395.57
(3) 补充流动资金	77,039.40
其中：本年度补充流动资金	7,160.00
加：累计利息收入（减手续费）	5,834.84
其中：本年度利息收入（减手续费）	40.91
募集资金应有结余	4,080.70
(1) 募集资金专项账户期末余额	3,580.70
(2) 用于现金管理尚未到期金额	500.00

## （二）向特定对象发行股票

单位：万元

项目	余额（元）
募集资金专项账户结余	400,507.73
截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	201,046.73
(1) 募集资金投资项目投入	121,046.73
其中：本年度募集资金投资项目投入	121,046.73
(2) 募集资金投资项目先期投入及置换	80,000.00
(3) 补充流动资金	
其中：本年度补充流动资金	
加：累计利息收入（减手续费）	1,462.04
其中：本年度利息收入（减手续费）	1,462.04
以自筹资金预先支付本次交易中介机构费用	77.74
募集资金应有结余	201,000.78
(1) 募集资金专项账户期末余额	2,000.78
(2) 用于现金管理尚未到期金额	199,000.00

公司 2025 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	名称	角色	直接持股数量（股）	直接持股比例
1	北京电子控股有限责任公司	控股股东、实际控制人	645,657,112	45.23%
2	刘锋	总裁、副董事长	150,000	0.01%
3	旷炎军	董事	150,000	0.01%
4	霍凤祥	执行副总裁、董事会秘书	120,000	0.01%
5	滕彦斌	财务总监	120,000	0.01%
6	周贺	执行副总裁	100,000	0.01%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 张林  
张 林

田东阁  
田东阁

